

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁵ H01L 21/00	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특 1992-0007068 1992년 04월 28일
(21) 출원번호	특 1990-0014379	
(22) 출원일자	1990년 09월 12일	
(71) 출원인	금성일렉트론 주식회사 문정환 충청북도 청주시 향정동 50번지	
(72) 발명자	이현우 경상북도 구미시 송정동 65번지 한우아파트 2동 409호	
(74) 대리인	김용인, 심창섭	

심사청구 : 없음

(54) 반도체 금속 박막의 스텝 커버리지 측정을 표준웨이퍼 제조방법

요약

내용 없음

대표도

도 5

명세서

[발명의 명칭]

반도체 금속박막의 스텝 커버리지 측정을 표준웨이퍼 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제5도는 본 발명의 공정 단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

실리콘 초기 웨이퍼위에 산화막을 성장시키고, 여러가지 형태의 스텝 커버리지 측정패턴이 내장된 마스크를 이용하여 사진감광과 사진식각 공정을 실시하며, 콘택트 슬로프를 각기 달리 만들 수 있도록 건식 에치를 구분지어 실시하고, 웨이퍼 흡을 애치할 수 있는 마스크를 이용하여 사진감광 후 웨이퍼흡을 식각함을 특징으로하는 반도체 금속박막의 스텝 커버리지 측정을 표준웨이퍼 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면5

